



半导体封装技术展览会 IC Packaging Fair 2023



覆盖华东地区 **200*** 家半导体封测厂



发现封测新采购力
EMS新发展封测业务的企业



参与听众人数 **1000*** 人



参与展示企业数 **200*** 家



3 条场景化生产线

3 大电子制造峰会

*数据为2023年预估数字

2023年7月19-21日 上海世博展览馆

同期展会



主办单位



励展博览集团
同励百业·共展商机

ICPF价值主张

汇聚 来自传统和新型半导体封测厂的买家资源，
通过 新颖的“场景化组线展示方案+行业峰会”的营销方式，
助力 高端半导体封测设备和材料供应商拓展业务机会和人脉，
帮助 供应商在半导体封测行业提升品牌价值。



加入 ICPF 您将有机会获得



迎合高端电子制造企业日益增长的“先进封装”需求，集中展示“SiP、3D封装等”技术方案

大会+演示，有效传递技术趋势



与全球顶尖先进封装及电子制造技术供应商并肩参展，提升品牌形象



覆盖华东地区数万名OBM、ODM及EMS电子制造买家，拓展高端人脉圈

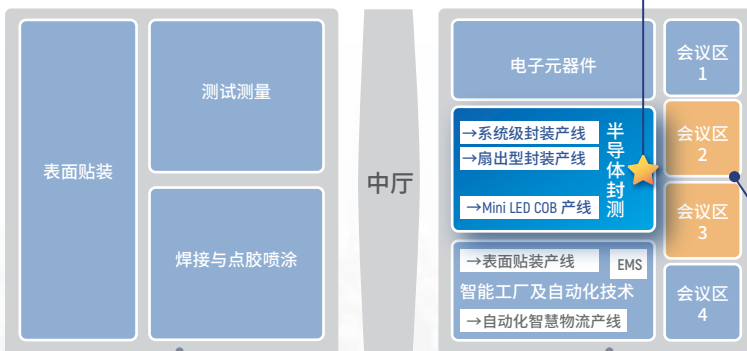


帮助您在SMT产业外拓展半导体封测业务机会！

线上线下多渠道整合营销，全年不间断带来更多市场曝光机会

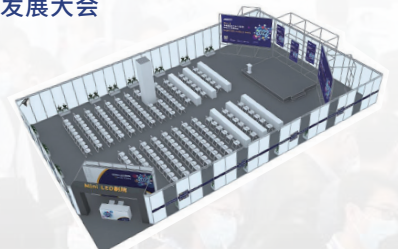
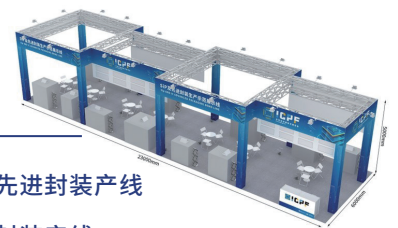


展会布局图



- 半导体系统级先进封装产线
- 半导体扇外型封装产线
- Mini LED背光模组COB工艺产线

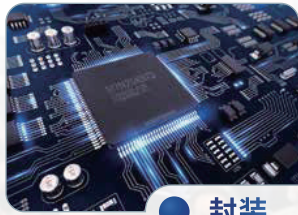
- ICPF封测技术大会
- ICPF封测行业发展大会
- Mini LED大会



1号馆 25,000m²
电子制造

2号馆 17,000m²
智能工厂 / 半导体 /
Mini LED / 电子元件

展示/演示范围



● 封装



● 测试



● IC设计



● EDA



● 半导体材料

往届规模



2019年
第一届中国国际电子制造峰会
先进封装技术论坛

听众规模 **300**人

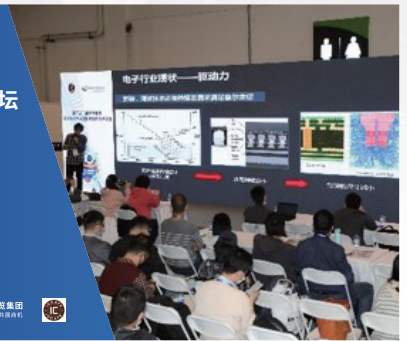
主办单位



2021年
第二届中国集成电路暨微
组装产业突围与创新高峰论坛

听众规模 **500**人

主办单位



往期嘉宾



徐伟

中国半导体行业协会 副理事长
上海集成电路行业协会 秘书长



滕冉

赛迪研究院
集成电路行业研究中心 总经理



赵成龙

上海韦尔半导体股份有限公司
MEMS 制程专家



谢鸿

通富微电子股份有限公司
SIU 技术中心总经理



张亦锋

广东利扬芯片测试股份有限公司
首席执行官



刘宏钧

苏州晶方半导体科技
股份有限公司
副总裁



陈清瑜

苏试宜特(上海)检测技术有限公司
处长



钟磊

甬矽电子(宁波)股份有限公司
工程研发总监



谢建友

首席分析师
前合道资产半导体行业合伙人
通富 SIP 首席科学家



赵健

环旭电子 股份有限公司
微小化系统模块暨先进制程
事业部(群) 副总经理



马青钢

杭州长川科技股份有限公司
销售总监



成刚

汉高(中国)投资有限公司
销售总监



刘一波

安靠封装测试(上海)有限公司
市场策略副总监



宋永琪

日东智能装备科技(深圳)
有限公司
技术研发中心副总监



彭一弘

锐杰微科技(集团)有限公司
高级研发总监



Santosh Kumar

Yole 韩国
首席技术分析师



Farhang Yazdani

BroadPak Corporation
总裁兼首席执行官



王启东

华进半导体封装先导技术
研发中心有限公司
研发部高级经理

往届到场观众 (部分)

安徽超元半导体有限公司
安徽泰斯特半导体有限公司
合肥市华达半导体有限公司
江阴易捷电子科技有限公司
马丁科瑞半导体技术(南京)有限公司
江苏嘉兆电子有限公司
京隆科技(苏州)有限公司
浦创电子科技(苏州)有限公司
苏州久元微电子有限公司
苏州矽科信息科技有限公司
芯冠(苏州)半导体有限公司
张家港保税区盛永泰电子检测服务有限公司
昆山芯信安电子科技有限公司
维顺特光电(苏州)有限公司
北京确实安科技股份有限公司无锡分公司
江苏七维测试技术有限公司
苏州矽科信息科技有限公司无锡分公司
无锡畅景科技有限公司
无锡长芯封测科技有限公司
无锡发润电子科技有限公司
无锡杰进科技有限公司
无锡晶测电子有限公司
无锡领测半导体有限公司
无锡品测科技有限公司
无锡市爱普达微电子有限公司
无锡市华宇光微电子科技有限公司
无锡威泰集成电路测试有限公司
无锡微可阳科技有限公司
无锡矽鹏半导体检测有限公司
无锡芯启博科技有限公司
无锡星杰测试有限公司
无锡圆方半导体测试有限公司

马鞍山市滨城电子有限公司
安徽华为硕半导体科技有限公司
芜湖启迪半导体有限公司
常州长源电子有限公司
常州史密斯半导体有限公司
常州市国润电子有限公司
常州顺舜电子有限公司
常州唐龙电子有限公司
常州新区佳琦电子产品有限公司
常州星海电子股份有限公司
常州欣盛半导体技术股份有限公司
常州英博科技有限公司
常州银河世纪微电子股份有限公司
江苏宏微科技股份有限公司
江苏矽莱克电子科技有限公司
江苏佑风微电子股份有限公司
江苏纳沛斯半导体有限公司
泰瑞科微电子(淮安)有限公司
江苏长电科技股份有限公司
江苏海德半导体有限公司
江阴华拓电子有限公司
江阴市金泰电子有限公司
江阴市州禾电子科技有限公司
江阴苏阳电子股份有限公司
江阴光电先进封装有限公司
星科金朋半导体(江阴)有限公司
中芯长电半导体(江阴)有限公司
日月光半导体(昆山)有限公司
华天科技(南京)有限公司
江苏芯德半导体科技有限公司
南京集正电子有限公司
南京矽邦半导体有限公司

安徽龙芯微科技有限公司
无锡红光微电子股份有限公司
天芯互联科技有限公司
无锡电基集成科技有限公司
无锡中微高科电子有限公司
英飞凌科技(无锡)有限公司
安徽吉来特电子有限公司
中芯集成电路制造(绍兴)有限公司
浙江天毅半导体科技有限公司
长电科技(宿迁)有限公司
沁阳群鑫电子有限公司
江苏爱矽半导体科技有限公司
江苏高格芯微电子有限公司
江苏中科芯智集成科技有限公司
联立(徐州)半导体有限公司
江苏固得沃克微电子科技有限公司
江苏恩微电子有限公司
力特半导体(无锡)有限公司
强茂电子(无锡)有限公司
无锡昌德微电子股份有限公司
无锡豪帮高科股份有限公司
浙江益中智能电气有限公司
江苏汇成光电有限公司
扬州虹扬科技发展有限公司
扬州恒爱电子科技股份有限公司
扬州肯达电子有限公司
扬州扬杰电子科技股份有限公司
江苏东晨电子科技有限公司
江苏晶度半导体科技有限公司
福建福顺半导体制造有限公司
安靠封装测试(上海)有限公司
统华电子科技(上海)有限公司

池州巨成电子科技有限公司
安徽钜芯半导体科技有限公司
池州睿成微电子有限公司
安徽康精翔电子有限公司
滁州硅迈科技有限公司
定远晶达半导体科技有限公司
长电科技(滁州)有限公司
安徽富芯微电子有限公司
安徽国晶微电子有限公司
合肥合晶电子有限责任公司
合肥速芯微电子有限公司
合肥通富微电子有限公司
合肥矽迈微电子科技有限公司
合肥新汇成微电子有限公司
捷敏电子(合肥)有限公司
苏州固锔电子股份有限公司
苏州捷研芯电子科技有限公司
苏州晶方半导体科技股份有限公司
苏州科阳半导体有限公司
苏州日月新半导体有限公司
苏州顺益新电子有限公司
苏州松下半导体有限公司
苏州通富超威半导体有限公司
苏州微邦电子有限公司
苏州英尔捷微电子有限公司
苏州震坤科技有限公司
海太半导体(无锡)有限公司
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
江苏东海半导体科技有限公司
江扬科技(无锡)有限公司
紫光宏茂微电子(上海)有限公司
浙江亚芯微电子股份有限公司

选择适合您的套餐

产线展示

31,800 元

菜单搭配

- ✓ 产线展区展位搭建及家具
- ✓ 搭建与展会期间设备用电用气
- ✓ 展前整合营销推广
- ✓ 现场品牌 LOGO展示

大会演讲

21,200 元

菜单搭配

- ✓ 展前整合营销推广
- ✓ 现场品牌 LOGO展示
- ✓ 25分钟演讲

产线展示+ 升级版大会演讲

53,000 元

菜单搭配

- ✓ 产线展区展位搭建及家具
- ✓ 搭建与展会期间设备用电用气
- ✓ 展前整合营销推广
- ✓ 现场品牌 LOGO展示
- ✓ 25分钟演讲
- ✓ 听众数据会后获取

套餐产品咨询



谷冰蓉 女士 / Julia Gu

021-2231 7010

julia.gu@rxglobal

市场推广合作



江圆极 先生 / Casper Jiang

021-2231 7033

casper.jiang@rxglobal.com



关注NEPCON
官方微信